**即時發佈**

**【Samtec 標誌】 2021** 七月

**Samtec 發佈 AcceleRate® HP** **高性能陣列系列**

*新型 PICMG COM-HPC® 互連解決方案之基礎*

**印第安納州、新奧爾巴尼：**Samtec Inc. 是一家擁有 8 億美元資產的私有企業。其作為全球電子互連解決方案製造商，自豪地宣佈發佈下一代 AcceleRate HP 高性能陣列。AcceleRate HP 具有超微型尺寸，可支持 112 Gbps PAM4 極致性能。

AcceleRate HP 高性能陣列採用開放式管腳場陣列，可最大限度地提高接地和佈線靈活性。系統架構師可以通過相同的互連將高性能差分對、單端信號和高電流電壓軌進行線路固定。

此外，2.2 / 2.4 / 2.2 毫米的行距簡化了差分信號的路由。因空間增加及在差分信號周圍添加更多接地過孔，進而減少了串擾。

Samtec, Inc. 高速板對板產品經理 Michael Boone 表示：「Samtec 的新型 AcceleRate HP 高性能陣列以小尺寸為高速 112 Gbps PAM4 性能設立了標準，人工智能加速器、ASIC 仿真器及下一代邊緣計算平臺等不斷增長的應用需要利用這些獨特的優勢。」

AcceleRate HP 高性能陣列的主要功能包括：

* 0.635 毫米的密集間距
* 5 毫米的低厚度和高達 10 毫米的堆疊高度
* 最多 400 個可用管腳
* 擁有 1,000 多個管腳的路線圖
* 數據速率與 PCIe® 5.0 和 100 GbE 兼容
* BGA 端接，便於組裝和自對準

有關 AcceleRate HP 高性能陣列的更多信息，請訪問 www.samtec.com/accelerateHP。

**PICMG COM-HPC 連接器**

新型 PICMG COM-HPC 規格採用一對基於 Samtec AcceleRate HP 高性能陣列的 400 管腳連接器，保證了系統和接口靈活性。Samtec COM-HPC 連接器將載體鏈接到服務器和客戶端模塊。其支持現有和未來的接口，例如 PCIe 5.0 及高達 100 GbE。連接器對支持 5 毫米或 10 毫米的堆疊高度。

有關 Samtec COM-HPC 連接器的更多信息，請下載 COM-HPC 互連解決方案電子版手冊、訪問 www.samtec.com/COMHPC 或向我們的技術專家發送電子郵件：COMHPC@samtec.com。

**關於 Samtec, Inc.：**

Samtec成立於1976年，是一家擁有8億美元資產的私有企業。其作為全球電子互連解決方案製造商，提供如下解決方案：高速板到板、高速電纜、中板及面板光學器件、精密射頻、靈活堆疊以及微／堅固組件和電纜。Samtec在全球 125 個國家設有 40 多家國際分支機搆並銷售產品，遍佈全球的機構使其可以為客戶提供最優的服務。

如需瞭解更多資訊，請訪問 http://www.samtec.com。

**Samtec, Inc.**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**電話：1-800-SAMTEC-9(800-726-8329)**

www.samtec.com

###

**媒體聯絡人:**

Matt Burns

matthew.burns@samtec.com

**電話：**812-944-6733